

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML1

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Laminieren (nicht SD-relevant)

| Materialtext | Mat. Nr. | µm | Aufbau | Prozessaufbau |
|--------------|----------|----|--------|---------------|
|--------------|----------|----|--------|---------------|

C-RS Pyralux AP8525E 305x457mm 0.050mm...

50200050

18

50

VS

1



A01

A-RS Klebefolie 3M 9460 50µm

50200608

50

2



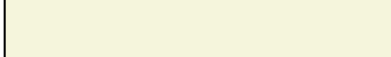
B00

A-RS-FR4-ML-0.15mm-018+018-TG150-HF

50200650

150

3



A02

Dicke nach Verpressen

B00:

270 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

320 µm

Dmin:

220 µm

Gesamtdicke über alles

425 µm

Tol+:

75 µm

Tol-:

75 µm

Dmax:

500 µm

Dmin:

350 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

300 µm

Tol+:

50 µm

Tol-:

50 µm

Dmax:

350 µm

Dmin:

250 µm

Messstelle:

(15) Dicke nach Verpressen

nominal:

268 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik